

证券代码：301312

证券简称：智立方

深圳市智立方自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2025 年度业绩说明会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 8 日 15:00-16:30
地点	进门财经平台（电话会议和网络文字互动形式召开）
上市公司接待人员姓名	董事长：邱鹏 董事、总经理：关巍 董事会秘书兼财务总监：廖新江 证券事务代表兼法务负责人：苏晓倩 保荐代表人：国联民生证券承销保荐有限公司秦亚中 独立董事：肖幼美、张淑钿、杜建铭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会通过电话会议和网络文字互动形式对公司 2025 年度经营、战略、财务情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。</p> <p><b>一、2025 年度经营、战略情况介绍</b></p> <p><b>1. 主营业务介绍：</b></p> <p>公司属于高端装备制造行业，是一家专注于半导体及工业自动化设备的研发、生产、销售及相关</p>

技术服务的国家级高新技术企业,为下游客户提供半导体工艺制程、半导体检测、智能制造系统、精益和自动化生产体系等定制化专业解决方案。

公司的核心业务聚焦于半导体设备及电子产品自动化设备两大领域。在半导体领域,公司重点布局半导体中后道工艺设备,围绕芯片检测、分选、固晶及封装自动化等关键工艺环节开展产品研发与技术积累,逐步形成覆盖显示半导体、光通信半导体、传感半导体、功率半导体、集成电路先进封装等领域的设备产品体系。

围绕半导体产业链关键环节,公司构建了较为完善的产品矩阵。在显示半导体领域,公司形成了以LED芯片高速分选设备、晶圆挑晶设备、Mini LED固晶设备及LED探针测试一体设备为代表的产品体系;在光通信半导体领域,公司开发了芯片外观检测设备巴条排列设备、芯片翻转摆放设备、共晶固晶设备及自动化生产设备等系列装备。在传感半导体领域,公司推出晶圆检测分选设备及CIS芯片分选设备;在功率半导体领域,公司推出软焊料固晶设备;在IC板级封装领域,公司开发了晶圆排片设备、IC检测分选编带设备、多芯片固晶设备及倒装贴片设备;上述产品能够应用于芯片检测、分选、封装及自动化生产等关键环节,通过自动化和智能化设备提升客户产线效率及产品良率。

电子产品赛道是公司的传统优势业务领域。公司自动化测试设备及自动化组装设备产品广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子、工业电子等行业,可满足客户在光学、电学及力学等多维度功能测试需求以及自动化组装需求。依托在自动化设备领域长期积累的技术优势,公司逐步将精密运动控制、机器视觉检测及自动化系统集成能力延伸至半导体设备领域。

公司基于半导体工艺、精密光学、精密机械、运动控制、软件开发及算法开发等技术基础及整体方案解决能力,适配半导体芯片及器件企业对设备精度、效率及稳定性的严格要求,通过持续研发创新及技术迭代不断提升设备性能,满足客户对高精度、高效率、高良率生产及自动化制造的需求。目前,公司已逐步进入多家半导体及光电器件制造头部企业供应链体系,通过技术协同开发不断深化合

作关系。

公司深耕行业多年，凭借工艺及技术研发能力、高效定制化响应能力、优质的产品质量及售后服务，与下游相关行业的多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包括苹果公司、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团、长光华芯、乾照光电、兆驰股份、华灿光电、源杰科技、光迅科技、中际旭创、菲尼萨、韦尔股份、格科微、矽迈微、士兰微等全球知名电子产品智能制造商及国内知名光电及 IC 企业。

## 2. 经营战略分析：

2025 年，公司继续围绕“半导体设备+电子产品自动化设备”双轮驱动推进业务发展。电子产品自动化设备是公司传统优势业务，广泛应用于消费电子、汽车电子、雾化电子等；半导体设备是公司重点发展的战略方向。公司依托精密运动控制、机器视觉、自动化集成、软件与算法等核心技术积累，持续加大半导体业务研发和市场投入，推动产品向检测、分选、固晶、先进封装等关键环节延伸。2025 年，公司半导体业务实现业务收入约 1.05 亿元，同比增长 48.96%，收入占比提升至 17.30%，已成为公司重要增长点。未来，公司将持续完善“深圳研发、东莞制造、苏州市场服务、新加坡国际化协同、越南本地化服务”的区域布局，进一步支撑半导体设备的业务拓展与全球化发展。

## 3. 财务情况回顾：

2025 年度，公司实现营业收入 60,652.58 万元，同比增长 9.36%；归属于上市公司股东的净利润 7,538.26 万元，同比增长 26.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,485.31 万元，同比增长 59.23%。

公司重视研发投入，围绕核心工艺设备及关键技术持续开展研发投入，重点布局精密运动控制、机器视觉算法、先进封装工艺及自动化系统集成等领域。2023 年至 2025 年研发费用分别为 5,425.99 万元、5,362.71 万元和 7,010.59 万元，占当期营业收入比例分别为 12.70%、9.67%、11.56%。

## 二、主要问答环节

### 1. 2025年净利润增速高于收入增速，主要原因是什么？

回复：2025年公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速均高于营业收入增速，反映出公司在业务结构、产品毛利、费用控制等方面取得一定改善。报告期内，公司半导体设备业务持续放量，消费电子等传统业务保持稳定，同时综合毛利率同比提升，带动盈利质量改善。

### 2. 2026年一季度收入增长但利润下降，如何理解？

回复：2026年一季度，公司实现营业收入1.93亿元，同比增长19.97%，收入端延续增长；归属于上市公司股东的净利润1,440.71万元，同比下降42.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,001.96万元，同比下降49.99%。利润阶段性承压主要受研发投入增加、汇率波动导致财务费用变化、政府补助等其他收益同比减少等因素影响。公司仍将坚持围绕核心业务和重点新产品进行研发及市场投入。

### 3. 半导体业务进展如何？是否成为核心增长引擎？

回复：半导体设备业务是公司重点发展的战略方向。2025年，公司半导体业务实现收入约1.05亿元，同比增长48.96%，收入占比由2024年的12.70%提升至17.30%。公司已围绕显示半导体、光通信半导体、传感半导体、功率半导体、IC板级封装等领域形成产品布局，半导体业务正在成为公司重要增长驱动力。

### 4. 公司半导体设备主要覆盖哪些产品和应用？

回复：公司半导体设备重点布局中后道工艺环

节，围绕芯片检测、分选、固晶及封装自动化等关键工艺开展研发和产品化。具体包括 LED 芯片高速分选设备、晶圆挑晶设备、Mini LED 固晶设备、光通信芯片外观检测设备、巴条排列设备、共晶固晶设备、CIS 芯片分选设备、软焊料固晶设备、IC 检测分选编带设备、多芯片固晶设备及倒装贴片设备等。

**5. 公司研发费用持续增加，会不会影响短期利润？**

回复：研发投入增加可能会对短期利润形成一定影响，但公司认为这是围绕长期竞争力建设的必要投入。2025 年公司研发投入约 7,010.59 万元，同比增长 30.73%，占营业收入比例为 11.56%；2026 年一季度研发费用约 2,208.73 万元，同比增长 37.66%。公司将持续围绕半导体设备、新产品迭代、核心工艺能力等方向进行投入。

**6. 公司毛利率改善的原因是什么？**

回复：2025 年公司综合毛利率为 31.27%，同比提升 4.58 个百分点。其中，消费电子业务毛利率为 34.40%，同比提升 4.21 个百分点；半导体业务毛利率为 18.42%，同比提升 15.86 个百分点。毛利率改善主要与产品结构变化、部分设备规模化交付、成本管控及项目交付结构等因素有关。

**7. 半导体业务毛利率目前仍低于消费电子业务，后续怎么看？**

回复：半导体设备业务仍处于持续拓展和产品迭代阶段，不同产品类别、客户验证阶段及交付规模会影响毛利率表现。2025 年半导体业务毛利率同比已有明显提升，后续公司将继续通过产品标准化、平台化、规模化交付以及工艺优化提升经营质量。但具体毛利率水平受产品结构、市场竞争、客户需求及交付验收节奏影响，存在波动。

**8. 请简述公司在半导体赛道的全球化区位**

### 布局上有哪些具体规划？

回复：公司将以“横向技术延伸+纵向行业深耕”双轮驱动战略为核心，推动半导体设备业务持续突破，构建“产品+行业+服务”协同发展的业务布局。

一方面，公司将横向拓展产品矩阵，围绕半导体关键工艺环节，持续向芯片检测、分选、固晶、封装自动化等方向延伸，丰富高附加值设备产品线；另一方面，公司将纵向深化行业应用，聚焦Mini/Micro LED、光通信、传感芯片、射频芯片及IC封装测试等细分领域，联合战略客户开展定制化工艺解决方案开发，提升行业渗透率。

在光通信半导体领域，公司将围绕光芯片、光器件、光模块制造及封装工艺需求，持续推进芯片外观检测、巴条排列与拆分、芯片摆盘、共晶固晶及光模块自动化线等关键装备的研发和市场拓展。

整体来看，公司将通过产品矩阵拓展、行业场景深化和服务模式创新，持续拓宽半导体设备应用边界，推动半导体设备业务规模增长和核心竞争力提升。

### 9. 请简述公司如何通过战略布局实现半导体设备业务的持续突破？

回复：公司通过横向拓展产品矩阵、纵向延伸行业应用，逐步完善覆盖显示半导体、光通信半导体、传感器芯片、射频芯片及IC封装测试等领域的半导体设备产品体系。同时，公司将深化与核心客户的协同开发，提升由单机设备向整线解决方案、由设备交付向综合工程技术服务延伸的能力。

在区域布局方面，公司将持续完善深圳研发、东莞验证交付、苏州市场服务、新加坡产业协同、越南及东南亚市场拓展的全球化布局，进一步提升研发创新、客户响应和国际化运营能力，推动半导体设备业务持续突破。

**10. 请简述公司在半导体赛道的区域协同布局规划？**

回复：公司将结合半导体设备业务发展需要，围绕研发、生产、市场及服务能力建设，持续完善半导体赛道的区域协同和全球化布局。

在国内布局方面，深圳将定位为公司半导体业务的研发中枢，聚焦核心技术攻关、产品迭代升级及关键工艺能力提升；东莞依托大湾区 Mini/Micro LED 等产业集群优势，强化专业化生产、规模化制造和快速交付能力；苏州面向长三角半导体产业链及重点客户资源，强化区域市场覆盖、客户需求响应和营销服务联动。

在海外布局方面，新加坡作为公司国际化业务协同、海外半导体产业资源链接和国际客户服务的重要节点；越南作为辐射东南亚市场的重要支点，完善本地化服务能力，提升海外客户响应效率。

**11. 一季度公司倒装键合设备的客户导入情况如何？未来市场前景及发展规划怎样？**

回复：一季度公司倒装键合设备已通过行业展会面向客户批量亮相，目前整体处于客户样品导入及认证阶段。从行业趋势来看，倒装键合是先进封装领域的核心增长赛道，市场前景广阔；后续公司将围绕 IC 封测、光通讯、Micro LED 等应用领域，持续布局多品类、多系列倒装键合设备，稳步拓展市场应用与客户覆盖。

**12. 请公司简述与瑞士施耐博格的合资公司（施耐博格深圳）进展及未来规划。**

回复：2025 年是深圳施耐博格完整运营的第二个会计年度，随着技术导入、产品开发、客户验证及交付体系建设的持续推进，深圳施耐博格的经营能力和商业化能力进一步提升，业务发展由前期能力建设逐步进入客户合作深化和稳定交付阶段，为后续规模化发展奠定基础。未来，深圳施耐博格

	<p>将继续依托智立方在自动化测试与组装领域的产业经验,以及瑞士施耐博格在高精度运动平台、矿物铸造等方面的技术积累,重点拓展半导体检测与量测、先进封装、超精密激光及生命科学设备等高端制造应用,为公司半导体装备业务布局形成协同支撑。</p> <p><b>13. 在目前形势下,客户订单情况有无变化?展望二季度会是什么趋势?</b></p> <p>回复:公司国内外客户的生产规划和订单在按计划快速推进,呈现明显上升趋势,整体看对全年业绩保持乐观。</p> <p><b>14. 请公司简述 2025 年分红计划及未来分红政策。</b></p> <p>回复:公司 2025 年拟每 10 股派现 3 元(含税),转增 4 股,现金分红总额为 36,354,183.60 元,占归属于上市公司股东的净利润的 48.23%。公司坚持“持续回报股东”原则,在兼顾公司发展和业务开拓的基础上,公司希望加大分红力度与频次,与投资者持续共享收益,敬请关注后续信息披露情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 8 日